

证券代码：603061

证券简称：金海通

公告编号：2026-013

天津金海通半导体设备股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2026年2月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年1月29日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事7人）。

会议由董事长崔学峰召集并主持，部分高级管理人员列席。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下，公司拟使用总额不超过人民币2.2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司将选择安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等）作为投资产品品种。为保证投资风险可控，该等产品不得用于质押，不得用于证券投资为目的的投资行为。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-014）。

（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

为满足公司全资子公司 JHT SEMICONDUCTOR SDN. BHD.（以下简称“马来西亚槟城金海通”）生产经营和业务发展的资金需求，公司拟为马来西亚槟城金海通贷款业务提供担保，担保额度预计不超过人民币 1,500 万元（含美元、林吉特或其他等值货币）。具体授信品种、担保金额、担保期限、担保方式等内容，由公司及全资子公司与债权人在以上额度内协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-015）。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司
董事会

2026 年 2 月 4 日